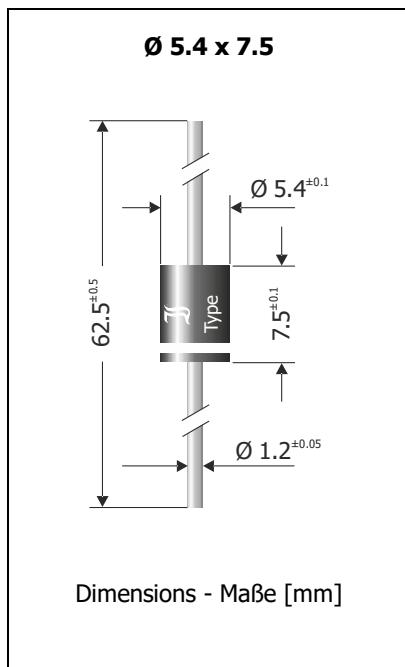


20SQ045-3G
Schottky Barrier Rectifier Diodes 3rd Generation
Schottky-Gleichrichterdioden 3. Generation
I_{FAV} = 20 A**V_{RRM}** = 45 V**V_{F@5A}** < 0.43 V**I_{FSM}** = 310/350 A**T_{jmax}** = 150°C**V_{F125}** ~ 0.25 V @ 5 A

Version 2018-09-27

**Typical Applications**
 Solar Bypass Diodes, Polarity Protection, Free-wheeling diodes, Output Rectification in DC/DC Converters
 Commercial grade ¹⁾
Features
 Best trade-off between V_F and I_R ²⁾
 Much smaller package outline than industry standard
 Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹⁾
**Mechanical Data ¹⁾**

Taped in ammo pack	500	Gegurtet in Ammo-Pack
<i>On request: on 13" reel</i>	1000	<i>Auf Anfrage: auf 13" Rolle</i>
Weight approx.	1.7 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen
	MSL N/A	

Typische Anwendungen
 Solar-Bypassdioden, Verpolschutz, Freilaufdioden, Ausgangsgleichrichtung in Gleichstromwandlern Standardausführung ¹⁾
Besonderheiten
 Optimale Auswahl von V_F und I_R ²⁾
 Gehäusegröße sehr viel kleiner als Industriestandard
 Konform zu RoHS, REACH, Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet in Ammo-Pack	500	<i>Auf Anfrage: auf 13" Rolle</i>
<i>On request: on 13" reel</i>	1000	
Weight approx.	1.7 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s	Löt- und Einbaubedingungen
	MSL N/A	

Maximum ratings ³⁾

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Grenzwerte ³⁾
20SQ045-3G	45	45	

Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom in Einwegschaltung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	I_{FAV}	20 A ⁴⁾
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwelle 50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	310 A 350 A
Rating for fusing Grenzlastintegral	$t < 10 \text{ ms}$	i^2t	480 A ² s
Junction temperature – Sperrschiesschichttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T_j	-50...+150°C $\leq 200^\circ\text{C}$ ^{2,5)}
Storage temperature Lagerungstemperatur		T_s	-50...+150°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierte Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 For more details, ask for the Diotec Application Note "Reliability of Bypass Diodes"
 Weitere Infos in der Diotec Applikationsschrift „Reliability of Bypass Diodes“

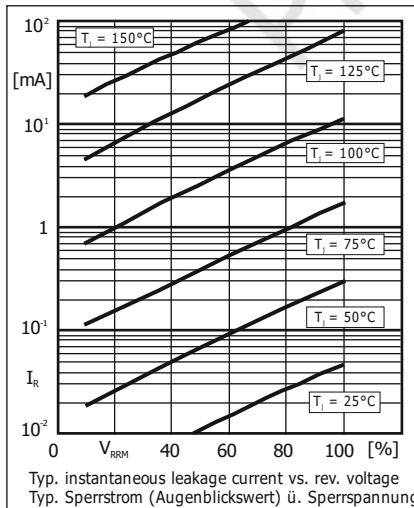
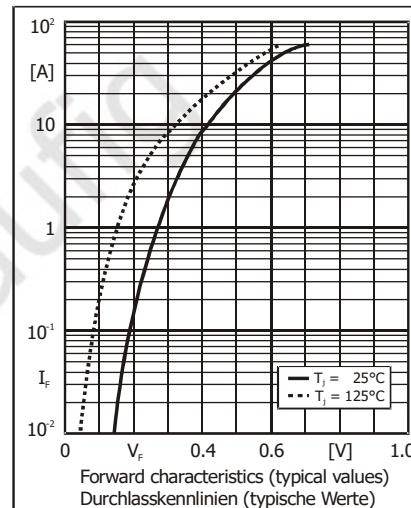
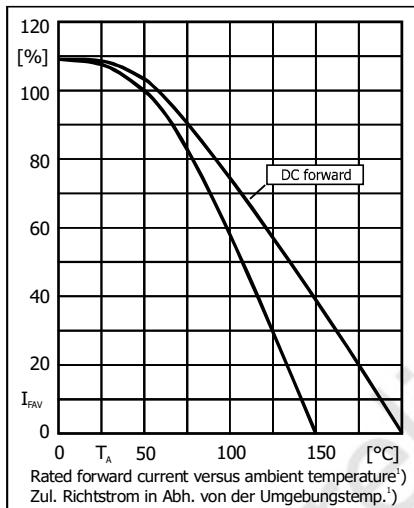
3 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben

4 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

5 Meets the Requirements of IEC 61215 bypass diode thermal test
 Erfüllt die Anforderungen des IEC 61215 Bypass-Diodentests

Characteristics
Kennwerte

Type Typ	Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung		
	V _F [V]	@ I _F [A]	@ T _j	V _F [V]	@ I _F [A]	@ T _j
20SQ045-3G	< 0.43 typ. 0.25	5	25°C 125°C	< 0.55	20	25°C
Leakage current Sperrstrom			T _j = 25°C T _j = 100°C	V _R = V _{RRM}	I _R	< 200 µA typ. 10 mA
Typical junction capacitance – Typische Sperrsichtkapazität				V _R = 4 V	C _J	720 pF
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrsicht-Umgebung					R _{thA}	12 K/W ¹⁾
Typical thermal resistance junction to lead (at the case) Typischer Wärmewiderstand Sperrsicht-Anschlussdraht (am Gehäuse)					R _{thL}	2.5 K/W ²⁾


Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden
- 2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden